

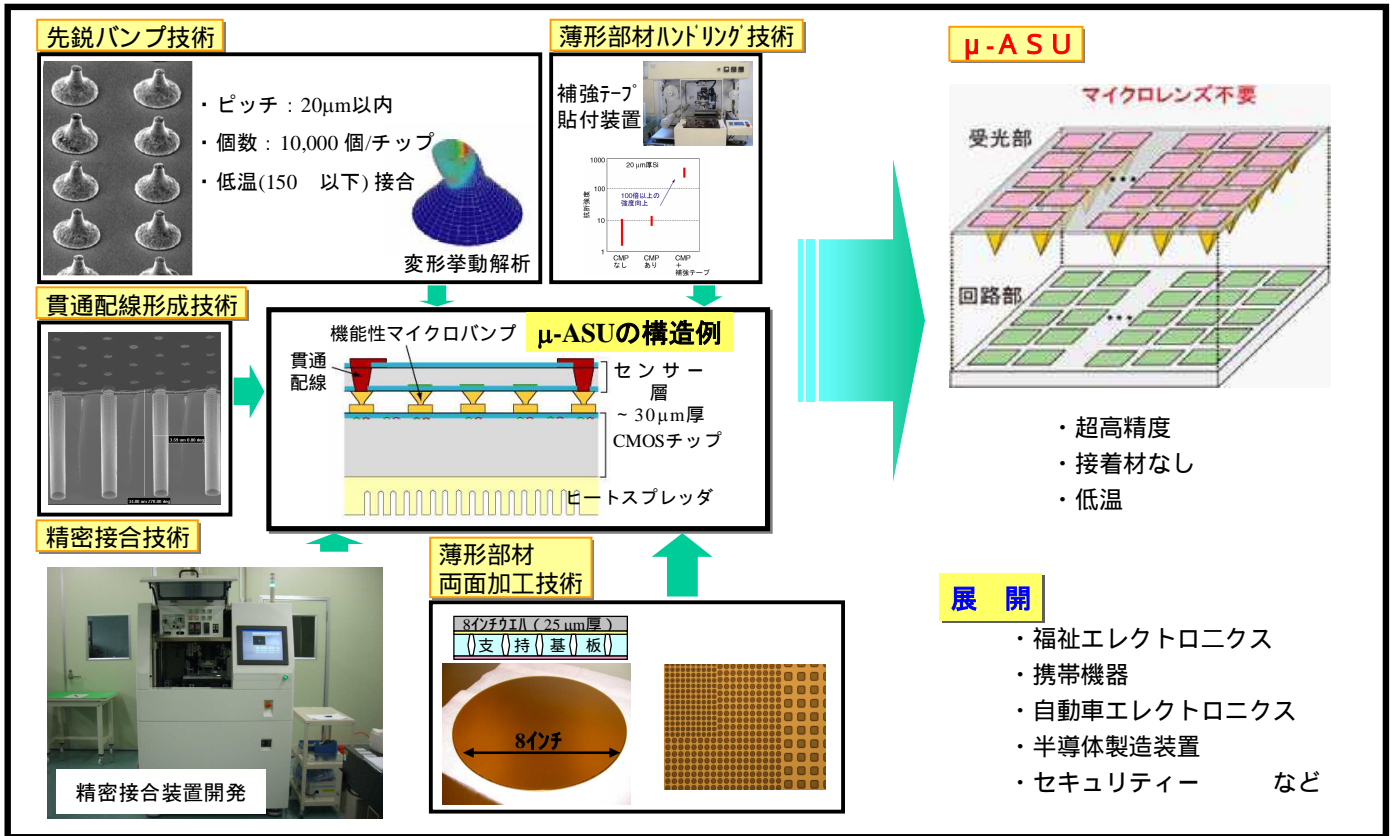
九州地域産業クラスター・電子部材高度加工技術の確立

本研究は、九州の主力産業である自動車や情報家電向け半導体・デバイス小型電子部材製造産業を強化する目的で実施するものです。半導体イノベーション協議会技術創造WG/SiP研究会から発足したコンソーシアムTACMIの成果をさらに発展させるものです。

技術開発目標		現有する技術	高度化・摺り合わせ目標		
くまもとテクノ産業財団・事業開発センター ものづくり革新技術の集中研究・発信 電子系 機械系	薄形化・ハンドリング技術	ENG CMOSセンサー技術 	<目標> 厚さ30μm以下 面粗さ<10nmRMSの 両面精密研磨技術 両面配線技術 厚さ30μm以下の 薄形部材を搬送、 切断、組立てる技術	<現状> 50μm 100nm 片面 50μm	
		触媒化成 ナノ粒子制御技術 			2千接点 → 34万接点を完全に 接合する技術 30μmサイズ 50μmピッチ
		原精機 ウエハ搬送、組立 			
	精密接合技術	吉玉精鍍 鍍金技術 	昇温状態で位置整合精度 1μm接合装置の開発	5μm	
		PMT セラミクス精密加工 			
		μ-ASU 組込み・周辺技術 マイクロ加工部材 			高信頼小型ケーシング 小型・高効率放熱機構

- ・シーズ技術提供 九州大学 産業技術総合研究所
- ・解析、定量化 熊本大学 熊本県産業技術センター
- 鹿児島大学 崇城大学 九州産業大学

- ・ユーザーニーズ提供 ログックリサーチ
- ・販路開拓支援 国立リハビリセンター (株)暖



PM: 鶴島稔夫 PL: 浅野種正 SPL: 廣津総吉

<参画機関> ENG(株)、原精機産業(株)、吉玉精鍍(株)、(株)PMT、触媒化成工業(株)、(株)測上ミクロ、(独)産業技術総合研究所、九州大学、熊本大学、鹿児島大学、崇城大学、九州産業大学、熊本県産業技術センター、財団事業開発センター(集中研究場所) 他
 <管理法人> (財)くまもとテクノ産業財団